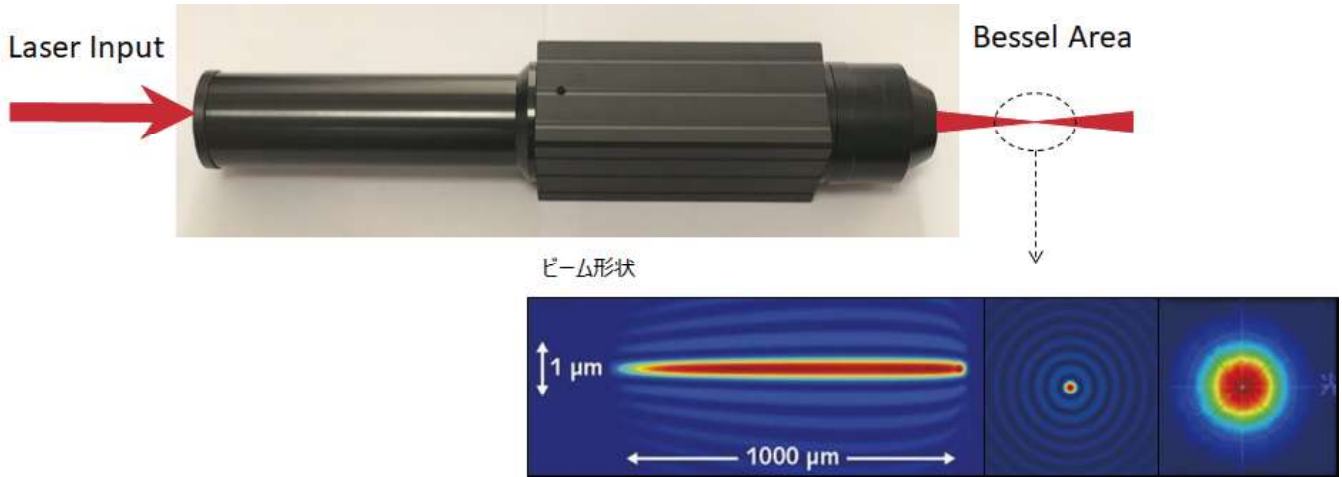


レーザー加工の新提案



レーザービアカッター

0.15mm~5mmの広範囲内で、幅広い焦点深度をご提供

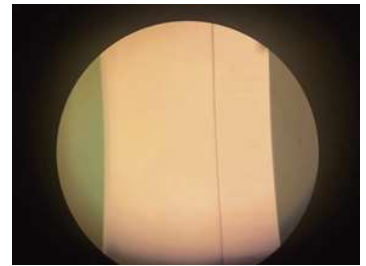


特徴

- ベッセルビームの原理を利用し、レーザー光の集光焦点深度を伸ばす一体加工ヘッドユニット
- 0.15mm~5mmの広範囲内で、幅広い焦点深度をご提供可能
- 加工端面が鏡面に近い効果を実現、簡単にブレーキング可能
- 対応波長 532nm、1064nm
- お客様の用途に合わせたカスタマイズも、お気軽にご相談ください。
(カスタマイズによって、同軸観察によるアライメントや加工の同時観察も可能です。)

用途

- 全面ディスプレイ携帯カバーガラスの微細加工
- 携帯電話搭載カメラの保護ガラスの切断加工
- サファイア切断加工
- シリコンや液晶パネルの切断加工



ガラス切断面サンプル

仕様

型番	波長	焦点深度DOF	入射ビーム径	作動距離WD
EC-11	1064nm	1.4mm	8mm	8mm
EC-12	532nm	1.4mm	8mm	9mm
EC-21	1064nm	0.4mm	8mm	8mm
EC-22	532nm	0.4mm	8mm	9mm

渋谷光学では、大手の光学メーカーでは高額になる特注品の製作もリーズナブルな価格と、独自の光学設計でお応えします。



株式会社渋谷光学 営業時間 / 月-金 9:00-17:30 (土日・祝日休業)

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉3-22-2 TEL: 048-469-1200 / FAX: 048-469-1311